

# 深圳市德明利技术股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	富国基金、国联基金、南方基金、东海基金、交银基金、招商基金、前海开源、兴银理财、招商资管、海通资管、太平洋保险、海港人寿、瑞信致远、展博投资、望正资产、时通运泰基金、磐耀资产、利信资产、长城证券、中银国际
时间	2023年10月12日 14:00-16:00
地点	深圳市福田区新一代产业园1栋A座24楼公司会议室
上市公司接待人员	李虎、于海燕、彭震
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;"><b>1、最近有报道称三星四季度上调 NAND 出厂价超 10%，请问目前原材料与产品价格涨幅如何，二者最终涨幅是否会保持同步？</b></p> <p>受原厂持续减产影响，存储行业供需情况有所改善，三季度以来原材料与产品价格均出现不同程度上涨。投资者可以关注存储领域行业媒体与市场机构，了解具体价格情况。存储产品成本中原材料占比较高，产品出售价格受原材料价格影响较大，同时也需要考虑终端需求以及价格传导周期等因素影响，因此最终涨幅情况暂无法确定。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、公司能介绍一下自研主控的主要优势体现在什么地方？</b></p> <p>自研主控作为存储器产品的核心器件之一，不同容量存储器中成本占比有所不同，公司采用自研主控，能够有效降低存储器产品成本，提高公司产品综合毛利率，更好地应对存储晶圆价格周期波动。同时，自研主控能够帮助公司更灵活地更高效地进行产品功能开发和调整。此外，自研主控的研发与优化需要同时匹配存储晶圆厂技术特征和下游实际应用需求，有助于公司与二者保持黏性，巩固供应链关系。</p> <p style="text-align: center;"><b>3、有行业媒体报道中说目前存储模组厂商出现惜售情形，公司目前</b></p>

## 销售策略是怎样的？

目前行业整体已经达成了涨价共识，但价格传导需要时间，存储原厂涨价幅度与现货市场价格走势存在一定滞后，导致出现部分厂商低价库存惜售情况。此外，受存储原厂减产影响，部分厂商原材料采购不足，也是惜售的原因之一。公司将根据实际情况，视业务重要性，灵活调整产品销售价格与规模，争取收益最大化。

## 4、请介绍一下存储行业的特性？

存储行业是强周期性产业，上游存储原厂集中度较高，产品价格波动较大，同时存储产品设计与生产也存在较高的技术门槛。因此，要求存储模组厂需要同时具备强大的供应链资源、人才储备与资金实力。公司深耕存储行业多年，积累了丰富的产业链资源，持续聚焦闪存主控芯片与固件方案，建立了完善的研发体系，未来将继续依托上市平台，加大研发投入，进一步提升公司经营规模与核心竞争力。

## 5、目前下游需求复苏情况怎么样，认为接下来的增长主要来自哪些领域？

下游各个应用领域景气度存在较大差别，但整体正显露复苏迹象。AI服务器、汽车电子等板块近期受市场关注度较高，近期行业新政策推行将进一步带动云服务器景气度回升；手机方面受品牌厂商新机发布、卫星电话等新功能推出有望带动市场迎来新一轮换机潮；PC市场受设备更新周期，以及Windows 10支持的结束影响，市场调查机构IDC统计数据，2023年第3季度全球PC出货量环比增长了11%。下半年作为传统旺季，公司将加快固态硬盘销售节奏与嵌入式产品客户导入，努力取得更好的业绩表现。

## 6、可以介绍一下公司各个业务线的产品进展么？

公司目前已经建立了完整的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储。

移动存储业务，公司产品较为成熟，除了传统消费级产品外，进

一步开发了工规级、商规级、宽温级、高耐久存储卡产品，可适用于对产品稳定性要求较高的复杂环境。公司自研主控芯片 TW2985（SD6.0 存储卡主控芯片）进入回片验证阶段，验证通过后配合量产工具即可快速导入公司移动存储模组产品中，未来公司也将持续推进最新工艺存储晶圆适配。

固态硬盘业务，公司消费级 SSD 相关产品同样较为成熟，上半年新增了 PCIe 4.0 SSD 产品，企业级 SSD 产品研发正在积极推进中，预计年内完成产品开发，并启动客户送样与产品导入。公司首颗自研 SATA SSD 主控芯片 TW6501 正在回片验证阶段，目前整体测试结果符合预期。未来公司将自研 PCIe SSD 主控芯片，积极开拓 PC OEM、服务器、数据中心等领域。

嵌入式业务，公司目前 eMMC 产品线完整布局车规、工规、高耐久及商规，已经实现小批量交付，目前正在积极推动更多客户验证与导入。另外，针对高速、大容量的应用，公司规划的 UFS 3.1 产品线已经具备量产能力，容量设定为 256GB-1TB。未来，公司也将自研嵌入式存储主控，推动嵌入式存储产品国产化进程。

**7、公司最新公告显示准备出售触控业务，公司未来的发展战略能具体介绍一下么？**

公司将有计划、有步骤地实现从移动存储市场向手机智能终端市场、PC 及其他电子终端市场、汽车电子市场、服务器和数据中心云存储等嵌入式存储市场以及高端固态硬盘市场的纵向发展。公司始终坚持以自主创新为驱动，以自研芯片为产品基础，以存储产品为业务主力，通过自研主控芯片+固件方案夯实产品竞争力。未来公司将进一步集中资源聚焦存储主营业务，提高公司资产运营效率，降低管理成本，提升公司盈利能力。

**8、公司目前存货情况如何，公司目前的存货结构如何？未来备货策略是怎么样的？三季度存货规模是否持续增长？**

近期投资者对公司存货情况关注度较高。今年上半年公司考虑未来嵌入式与固态硬盘业务发展需要，适当提升战略储备，存货规模有所增长，结构上增加了 Normal Wafer 的采购，Normal Wafer 占比提升。截至 6 月

30日，公司存货9.53亿元，其中原材料3.18亿元。目前存货规模已经能够满足公司经营需要，未来将视业务开展情况按需采购，不断优化存货结构。公司存货价值受影响因素较多，包括原厂的晶圆交付周期、销售情况、原材料和产品价格波动等，无法准确预估三季度末存货规模，具体请关注公司后续信息披露。

**9、能介绍一下 DRAM 和 NAND 的区别么？以及公司未来会布局 DRAM 或者封测环节么？**

DRAM 与 NAND 晶圆内部结构不同，NAND 是非易失性存储设备，同时工艺上 NAND 采用 3D 堆叠技术，导致二者完成数据读写擦除的过程存在较大差异，NAND 更为复杂，需要高性能主控芯片与固件算法支持，对于存储模组厂来说，NAND 模组的制造过程能够产生相对 DRAM 模组更高的附加值。公司目前积极推动的 PCIe 固态硬盘和嵌入式存储产品业务未来仍存在较大增长空间，因此短期内公司仍会依托核心竞争力专注闪存领域，聚焦主控芯片与固件方案。

**10、公司各个产品之间毛利率是否有明显差别？**

存储产品毛利率受原材料、容量大小、性能要求、下游需求等因素影响，对于公司而言，还存在主控芯片是否为自研的关键因素。整体来看，采用公司自研主控与固件方案的存储产品能够最大化利用存储晶圆价值，取得较好的毛利率水平。

**11、随着行业周期推进，公司移动存储板块未来是否也会迎来增长？**

移动存储产品主要包括存储卡与存储盘，下游应用领域广泛，占存储行业整体规模比例较为稳定。公司开展移动存储业务多年，积累了丰富的客户与渠道资源，推动营收规模持续增长。同时公司通过自研移动存储主控芯片，提高产品毛利率水平与产品竞争力。公司还进一步开发了工规级、商规级、宽温级、高耐久存储卡产品，拓宽应用场景，可适用于车载监控、行车记录仪、中控导航、灾备盒、部标机等对产品稳定性要求较高的复杂环境。随着行业周期推进，晶圆与模组产品的价格上涨，也有望进一步推

	<p>动公司移动存储营收规模增长。</p> <p><b>12、公司嵌入式与固态硬盘业务如果迎来较大增长,是否能够有效保证产能?</b></p> <p>公司产品主要通过委托加工方式生产,其中固态硬盘与嵌入式模组产品的委托加工工序主要包括芯片颗粒封装测试工序和模组产品贴片集成及测试工序。相关工序的生产工艺与原材料较为成熟,市场产能充足。公司深耕行业多年,供应链资源丰富,合作封装测试厂商较多,并自建有贴片、测试产线,能够有效保障业务增长所需的产能供给。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件)</p>	<p>无</p>